

SAICAS Application Note

剥離強度測定 ② / せん断応力測定 ② ～ シリコンウエハー上の超薄膜の評価 ～

資料番号:SC0007 / 公開日:2021.04.01

<概要>

SAICAS NN-05型は微小動作や微小荷重の計測が可能であり、100nm～数 μm といったサブミクロンの超薄膜の評価に適している。

そこでSAICASを用いたシリコンウエハー上の超薄膜の剥離強度とみなしせん断強度の計測事例について紹介する。

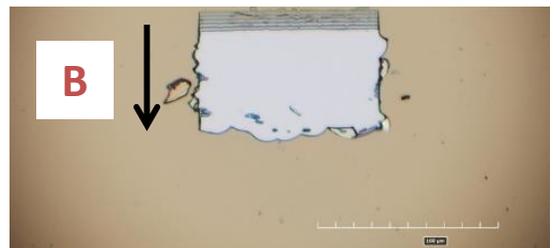
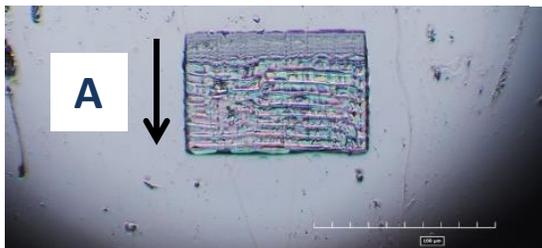
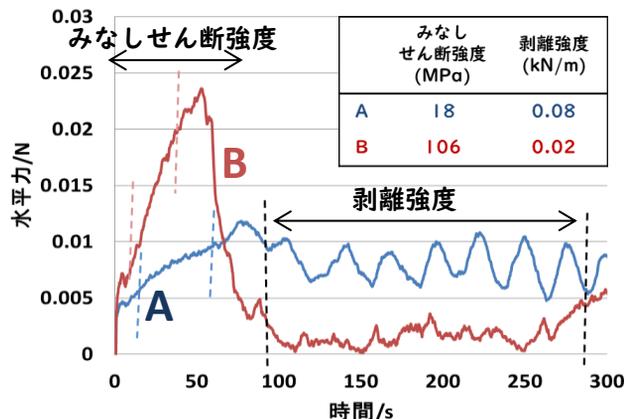
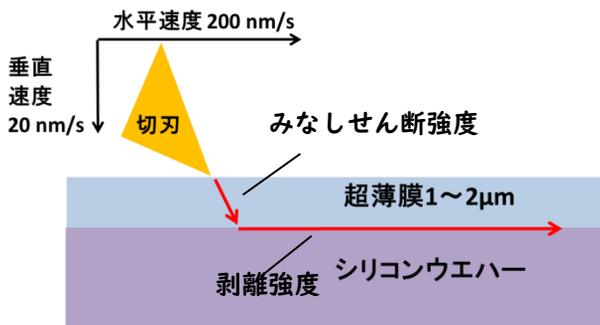
<試験>

試験体層構成：超薄膜(1～2 μm)/シリコンウエハー 2種 (A or B)

試験装置：SAICAS NN-05型 (分解能 0.001N)

切刃：ダイヤモンド切刃(刃幅0.1mmスクイ角20° ニゲ角10° C面60°)

<結果>



測定結果に関するお問い合わせは、dawin@wintes.co.jpまで



ダイプラ・ウィンテス株式会社
DAIPLA WINTES CO.,LTD.